

馬來西亞：SC 透過資本市場籌資方案協助半導體產業縮減資金缺口（8/19）

- 馬來西亞證管會（Securities Commission Malaysia, SC）持續協助微型、中小企業（Micro, Small and Medium Enterprises, MSMEs）及中型企業（Mid-Tier Companies, MTCs）資本市場籌資方案，並以半導體產業及其供應鏈企業為重點，協助業者掌握更多元的籌資管道，以支持業務擴張、技術導入及創新發展。相關措施亦配合 SC 推動之《促進 MSME 及 MTC 進入資本市場五年路徑圖》（Catalysing MSME and MTC Access to the Capital Market: 5-Year Roadmap）^{註 1}。
- 除傳統銀行籌資外，企業亦可透過資本市場取得資金，主要涵蓋以下 6 項管道：
 - 股權群眾募資（Equity Crowdfunding, ECF）
 - P2P 籌資（Peer-to-Peer Financing, P2P）
 - 創業投資（Venture Capital, VC）
 - 私募股權（Private Equity, PE）
 - 私人債務籌資（Private Debt）
 - 公開發行市場（Public Market）
- 透過《2030 年新工業藍圖戰略共同投資基金》（New Industrial Master Plan 2030, NIMP CoSIF）^{註 2}、ECF 及 P2P 籌資等機制，可協助半導體 MSMEs 及 MTC 籌措所需資金並提升競爭力。截至 2026 年 7 月底，NIMP CoSIF 已協助 42 家馬來西亞企業進行公私部門共同籌資，累計金額達 2 億 2,123 萬令吉（約新臺幣 17.29 億元）。
- SC 期望透過相關推廣與媒合活動，協助更多高成長企業取得資本市場資金、擴大營運規模，並支持《2030 年新工業藍圖》^{註 3}及《國

家半導體策略》（National Semiconductor Strategy, NSS）^{註4}之政策目標。相關措施亦呼應《2026 – 2030 年資本市場總體藍圖》（Capital Market Master Plan 2026 – 2030）^{註5}之「包容性」（Inclusivity）支柱。

註1：係由 SC 推動，旨在擴大微型、中小企業及中型企業取得資本市場籌資的機會，並透過多元籌資工具支持企業成長與規模擴張。詳參國際證券期貨市場 115 年 5 月份動態「馬來西亞證管會與交易所提出強化 LEAP 板草案公開諮詢」編號 260505 一文。

註2：為配合馬來西亞《2030 年新工業藍圖》所設之共同投資機制，透過公私部門共同投資方式，引導資金投入具成長潛力及策略重要性之企業與產業。

註3：為馬來西亞推動產業升級與經濟轉型之重要政策藍圖，重點包括提升產業複雜度、推動數位化與科技創新、邁向淨零排放，以及強化經濟韌性與包容性發展。

註4：為馬來西亞推動半導體產業升級與擴張之重要國家策略，著重吸引高附加價值投資、強化先進製造與研發能力、培育專業人才，以及提升馬來西亞在全球半導體供應鏈中之競爭力。

註5：詳參國際證券期貨市場 115 年 4 月份動態「馬來西亞證管會與交易所提出『My Value Up』計畫」編號 260413 一文。

資料來源：[馬來西亞證券委員會 SC](#)